

KULKI BGA

Do prac serwisowych podczas regeneracji wyprowadzeń BGA

OPIS i APLIKACJA

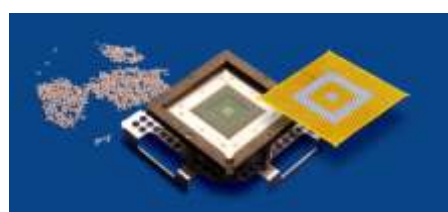


Kulki „**BGA-MARTIN**” to najwyższa jakość w odniesieniu do czystości spoiwa i idealnego kształtu. Pola lutownicze „smaruje” się topnikiem w żelu lub w mazaku, następnie pozycjonuje na nich kulki poprzez szablon odpowiadający kształtem i liczbą otworów ilości wyprowadzeń układu i lutuje gorącym powietrzem o dokładnie kontrolowanej temperaturze. Kulki dostępne są w różnych średnicach i odmianach aczkolwiek najczęściej stosowane stopy to: **Sn96,5Ag3Cu05** oraz **Sn63Pb37**. Optymalne warunki lutowania dla danego stopu analogiczne jak dla pasty lutowniczej do SMD. Do wymiany kulek w układach BGA polecamy urządzenia firmy **MARTIN** z serii **Reball**.



Rys. Kulki BGA w różnych opakowaniach

Średnica (µm)	600 ±25	500 ±25	400 ±25	300 ±12
Rodzaj stopu / T.t °C	Sn63Pb37/SAC305 183°C/217°C	Sn63Pb37/SAC305 183°C/217°C	Sn63Pb37/SAC305 183°C/217°C	Sn63Pb37/SAC305 183°C/217°C
Sztuk w opakowaniu	50.000	50.000	50.000	50.000
Masa netto opakowania	47/41g	27,0/23,5g	20,0/17,5g	6,0 / 5,2g



Rys. Topniki do lutowania w żelu, w mazaku i fragment zestawu do regeneracji wyprowadzeń BGA - Martin Reball 3.1

Kulki są konfekcjonowane w szklane lub plastikowe słoiki z wkładką silikażelową po 50 tys. sztuk. Składowanie w suchych pomieszczeniach.